

2027年3月期第1四半期決算説明会 議事録

参考資料:2027年3月期第1四半期決算説明資料

[https://www.mitsui-](https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=0uWRzPc1rtM%3d&tabid=100&mid=1060&TabModule819=0)

[kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=0uWRzPc1rtM%3d&tabid=100&mid=1060&TabModule819=0](https://www.mitsui-kinzoku.com/LinkClick.aspx?fileticket=0uWRzPc1rtM%3d&tabid=100&mid=1060&TabModule819=0)

(補足) PKG : パッケージ基板

HDI : マザーボード (High Density Interconnect)

差量:実収差量。想定・基準となる金属製錬の実収量と、実際の実収量との差

ASIC:Application-Specific Integrated Circuit (特定用途向け集積回路)

GPU:Graphics Processing Unit (画像処理装置)

■ご説明

2026年度第1四半期決算



- ・第1四半期前年同期比では、機能材料セグメントで極薄銅箔MicroThin™やAIサーバー向け電解銅箔VSP™など主要製品の販売量が増加したことや、金属セグメントで為替の円安、金属価格が上回って推移したことおよびそれに伴う在庫要因の好転等により、増収増益となった。また、当期純利益は前年同期に計上した関係会社株式譲渡に伴う特別損失の剥落により大きく好転した。
- ・通期予想は、機能材料セグメントで引き続き主要製品の販売量が好調に推移することから、金属セグメントで一部の金属価格が下落傾向にある影響などを織り込むも、前回予想比で増収増益を見込む。

(単位：億円)

	第1四半期実績			通期予想		
	2026 実績	2025 実績	増減 (26-25)	2026 今回予想	2026 前回予想	増減 (今回-前回)
売上高	2,016	1,690	326 19.3%	8,500	8,300	200 2.4%
営業利益	210	114	96 84.1%	940	910	30 3.3%
経常利益	235	100	135 134.3%	1,000	930	70 7.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	168	-60	228 -	800	750	50 6.7%

Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates All Rights Reserved.

1

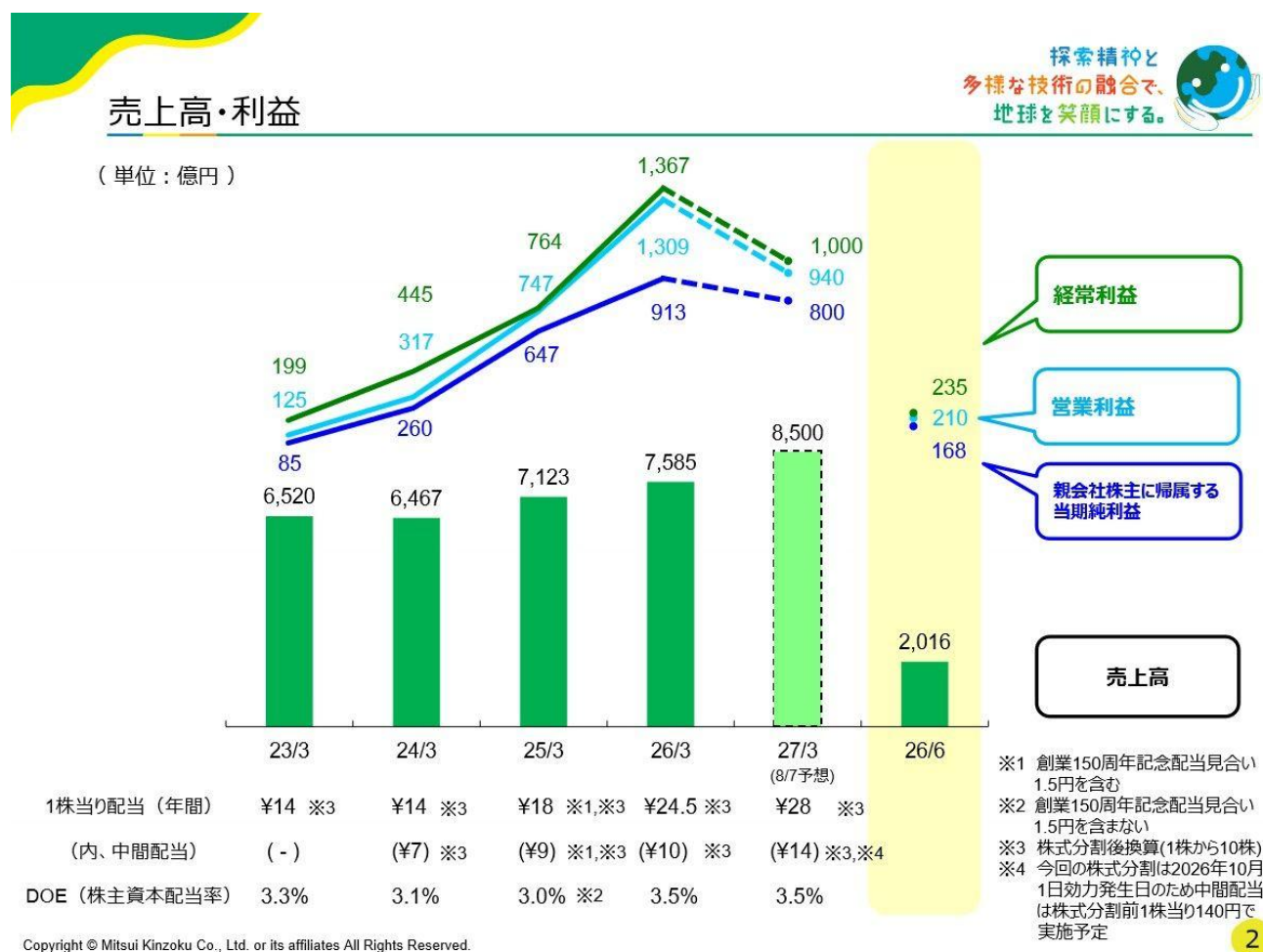
決算説明資料1ページをご覧ください。

・2026年度第1四半期の売上高は2,016億円、営業利益は210億円、経常利益は235億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は168億円となりました。対前年同期では、極薄銅箔MicroThin™やAIサーバー向け電解銅箔VSP™など、機能材料セグメントの主要製品の販売量が増加したことに加え、金属セグメントで為替の円安や金属価格が好転した影響などにより、当社グループ全体の売上高は326億円の増収となりました。

・利益につきましては、先ほどの要因に加え、金属セグメントでの在庫要因の好転や前年同期の三井金属

アクトの株式譲渡に伴う特別損失計上影響の解消などにより、営業利益で96億円、経常利益で135億円、親会社株主に帰属する四半期純利益で228億円の増益となりました。

- ・2026年度の通期予想につきましては、第1四半期の実績に第2四半期以降の事業動向などを踏まえて見直した結果、売上高8,500億円、営業利益940億円、経常利益1,000億円、当期純利益800億円と、前回5月13日に開示した通期予想を上回る見込みです。
- ・第2四半期以降の価格前提につきましては、LME亜鉛価格3,400ドル、鉛価格1,900ドル、銅価格612セント、為替は1ドル160円としております。



資料2ページをご覧ください。

- ・グラフの下に記載しております配当につきましては、前回5月13日に開示しましたとおり、中間配当は140円の予定としております。なお、本日開示しました、本年9月30日を基準日とする株式分割により、期末の配当予想を14円としております。これは株式分割後の換算によるものであり、前回予想からの実質的な変更はございません。

株式分割について

※2026年8月7日開示

「株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに
配当予想の修正に関するお知らせ」を併せてご参照ください



・目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図るため。

・概要

分割の方法 : 普通株式1株を10株に分割

基準日 : 2026年 9月30日(水)

効力発生日 : 2026年10月 1日(木)

※増加する株式数

	発行済株式総数	発行可能株式総数
株式分割前	57,420,389株	190,000,000株
株式分割後	574,203,890株	1,900,000,000株

・配当予想の修正(2027年3月期)

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (5月13日公表)	140円00銭	140円00銭	280円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	140円00銭 (※) (140円00銭)	14円00銭 (140円00銭)	— (280円00銭)
(ご参考) 前期実績 (2026年3月期)	100円00銭	145円00銭	245円00銭

(※) 第2四半期末配当金の支払いは、株式分割前の株式数を基準に実施

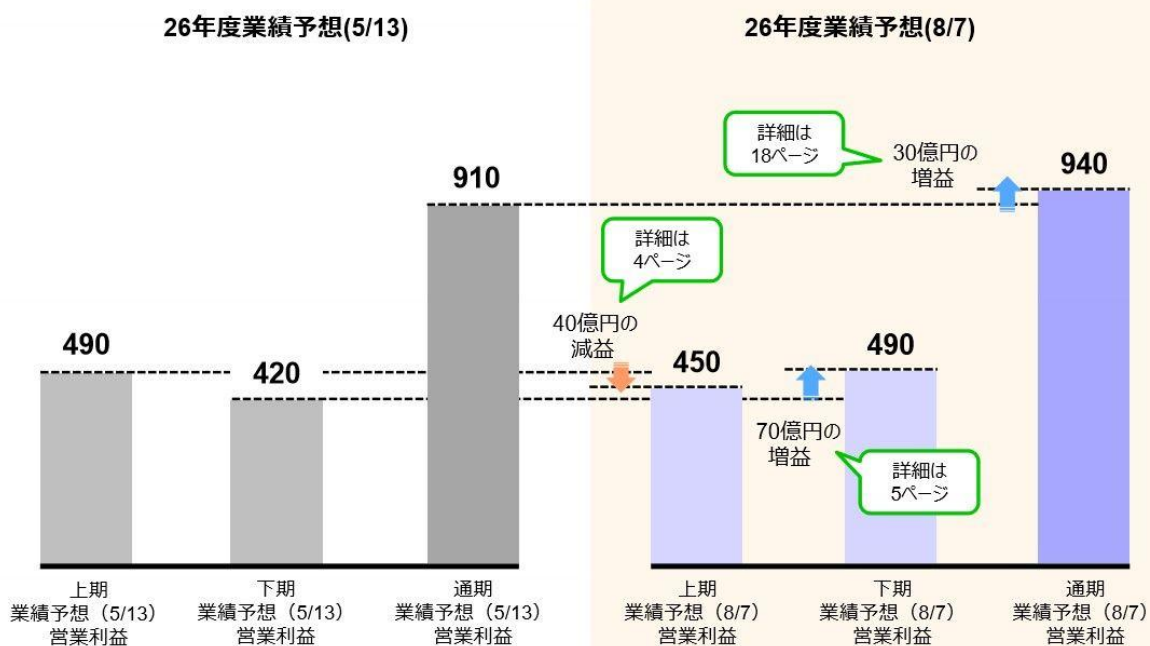
- ・株式分割は、投資単位当たりの金額の引き下げによって、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。詳細は資料25ページに記載しております。

26年度営業利益見込

26年度営業利益は、上期は前回業績予想比で40億円の減益を見込む

通期は前回業績予想比で30億円の増益を見込む

(単位：億円)



Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates All Rights Reserved.

3

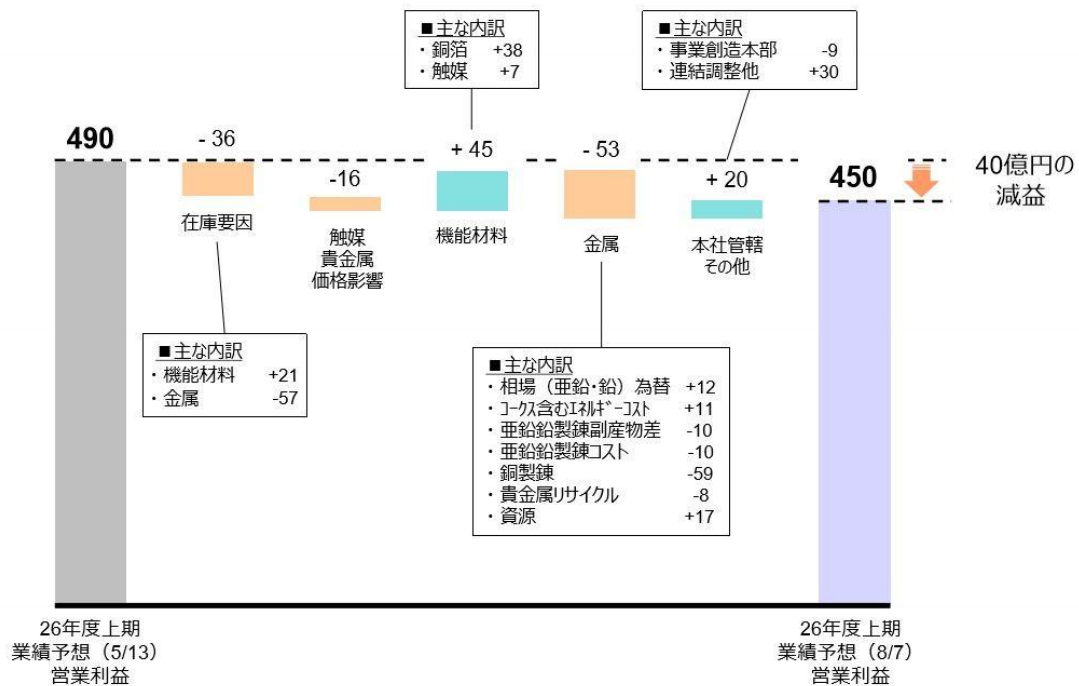
資料3ページをご覧ください。

- 26年度の営業利益につきましては、上期は前回比で40億円減益の450億円、下期は70億円増益の490億円、通期で30億円増益の940億円を見込んでおります。

26年度上期営業利益見込（対前回業績予想）



（単位：億円）



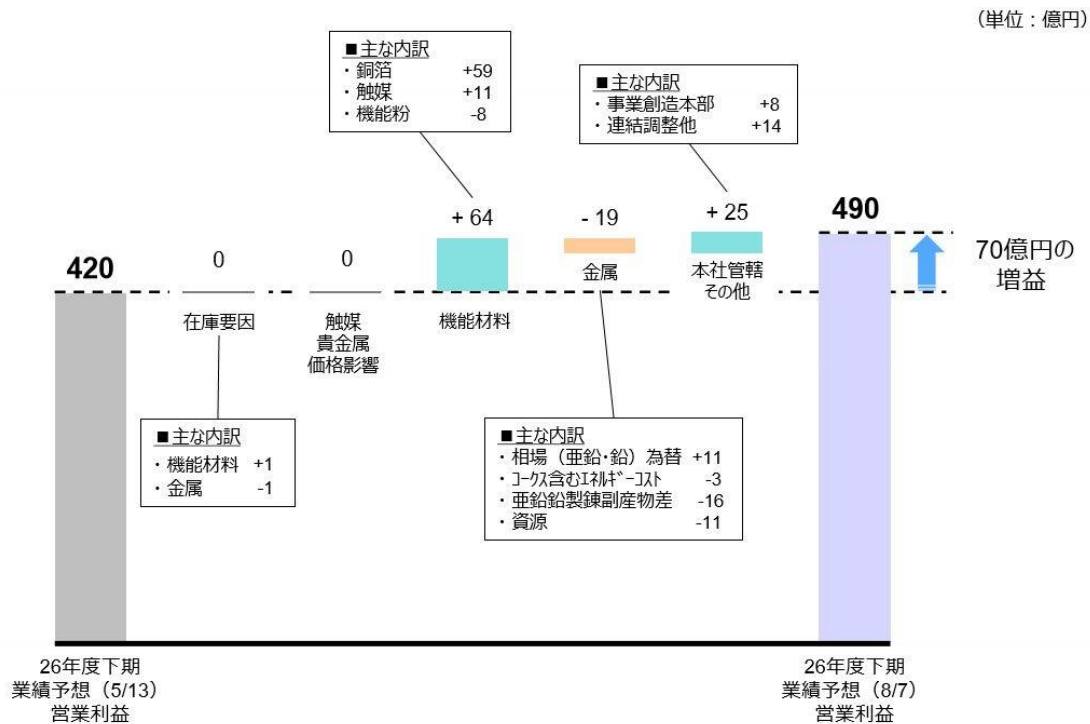
Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates All Rights Reserved.

4

資料4ページをご覧ください。

- ・上期営業利益の前回予想との差異につきまして、セグメント別では、機能材料で主に旺盛な需要に支えられた銅箔の増益があるものの、金属セグメントでの減益により、全体で40億円の減益を見込んでおります。

26年度下期営業利益見込（対前回業績予想）



資料5ページをご覧ください。

- ・下期営業利益の前回予想との差異につきましては、主に機能材料セグメントの銅箔MicroThin™の販売量増加などによる好転によって、全体で70億円の増益を見込んでおります。

銅箔主力製品の生産能力増強について



銅箔主力製品 (VSP™、MicroThin™、FaradFlex®) の増産により、
2030年経常利益（全社1,500億円、うち機能材料1,300億円）達成に向けて順調に進捗

■従来計画

VSP™

単位：t/月

	2025	2026	2027	2028
台湾工場	600	720	760	860
マレーシア工場	120	120	240	340
計	720	840	1,000	1,200

MicroThin™

単位：K-m2/月

	2024	2027	2030
上尾事業所	2,500	2,600	2,800
マレーシア工場	2,400	2,600	2,800
計	4,900	5,200	5,600

FaradFlex® (FF)

・2025年8月21日付ニュースリリース

・生産能力を2026年3月までに現行の1.6倍に

■今回最新計画 (赤枠は今回追加)

VSP™

単位：t/月

	2025	2026	2027	2028	2030
台湾工場	600	720	760	860	960
マレーシア工場	120	120	240	340	440
計	720	840	1,000	1,200	1,400

投資総額 70億円

MicroThin™

単位：K-m2/月

	2025	2026	2027	2028	2030
上尾事業所	2,500	2,500	2,600	2,800	検討中
マレーシア工場	2,400	2,400	2,600	3,200	検討中
計	4,900	4,900	5,200	6,000	8,000

投資総額 300億円

FaradFlex® (FF)

単位：K-m2/月

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
マレーシア工場	70	80	100	135	135	135
上尾事業所	5	5	35	60	85	85
台湾(新工場)	-	-	-	-	70	135
計	75	85	135	195	290	355

投資総額 50億円

- MicroThin™ははじめ各種製品の販売量次第では2030年業績上振れの可能性あり
- 2030年以降の更なる需要増に向けて、引き続き自社による新工場設立やM&Aなど検討中
→ 更なる企業価値向上へ

Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates All Rights Reserved.

6

資料6ページをご覧ください。

- ・本日、決算発表に合わせて2030年に向けて銅箔主力製品のVSP™、MicroThin™、FaradFlex®で、それぞれの投資総額を合わせて420億円の投資による生産能力増強を発表いたしました。これにより、月当たりの生産量でVSP™は720トンから1,400トンへ、MicroThin™は490万平米から800万平米へ、FaradFlex®は7万5,000平米から35万5,000平米へ拡大します。
- ・これらは、今後旺盛な需要増が見込まれるAIサーバー、通信インフラ、光モジュール、半導体パッケージ、基板用途向けの中長期需要を取り込む先行投資として、お客様への供給責任を全うするものであるとともに、5月21日の25中計進捗説明会でお示しました、2030年の経常利益、機能材料セグメントで1,300億円、全社で1,500億円の達成に向けて大きく前進するものであります。
- ・中でもMicroThin™は、2030年に従来計画の生産能力560万平米から、今回計画では800万平米に大きく増強する計画であり、販売量の増加次第では2030年の業績上振れの可能性もあります。
- ・また、2030年以降のさらなる需要増に向けて、引き続き自社による新工場設立やM&Aなどを検討中で、さらなる企業価値向上を目指してまいります。

営業外・特別損益



(単位：億円)

	第1四半期			上期			通期		
	2026 実績	2025 実績	増減 (26-25)	2026 今回予想	2025 実績	増減 (26-25)	2026 今回予想	2025 実績	増減 (26-25)
金利収支	-3	-5	1	-8	-9	1	-18	-14	-4
受取配当金	3	5	-2	3	5	-2	3	5	-2
持分法投資損益	28	8	21	47	14	33	66	74	-7
為替差損益	-4	-23	19	-4	-18	15	-4	-14	11
その他	0	0	0	-3	2	-5	12	8	4
営業外損益 計	24	-14	39	35	-6	41	60	58	2
固定資産除売却	-3	-3	0	-8	-8	0	-13	-28	15
減損損失	0	0	0	0	0	0	0	-5	5
有価証券売却損益	10	0	10	10	2	8	10	3	8
関係会社株式売却損益	0	21	-21	0	21	-21	0	-169	169
貸倒引当金繰入・戻入額	-1	-1	0	-1	12	-13	-1	12	-13
その他引当金繰入額	0	-197	197	0	-188	188	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	55	1	54
その他	-2	0	-3	-5	-2	-3	-11	-6	-5
特別損益 計	5	-179	184	-3	-163	160	40	-193	233

Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates All Rights Reserved.

11

引き続き、その他の項目についてご説明いたします。資料11ページの営業外・特別損益をご覧ください。

- 営業外損益については、第1四半期で対前年同期39億円の増益となっておりますが、これは主に持分法投資損益と為替差損益によるものです。
- 特別損益においては、前年同期の三井金属アクトの株式譲渡に伴う特別損失計上剥落などにより、対前年同期184億円の改善となっております。なお、8月3日付で持分法適用会社であるナカボーテック社の株式全部譲渡をリリースいたしましたが、損益の実現は第2四半期以降でございます。ただし本年度業績に与える影響は軽微と見ております。

主要製品の動向



			2024					2025					2026予想(8/7)					2026予想(5/13)		
			Q1	Q2	Q3	Q4	年間	Q1	Q2	Q3	Q4	年間	Q1	Q2 予想	上期 予想	下期 予想	通期 予想	上期 予想	下期 予想	通期 予想
機能材料	電解銅箔 販売量 t/月		1,680	1,650	1,680	1,600	1,650	1,750	1,980	1,970	1,700	1,850	1,750	1,750	1,750	1,740	1,750	1,840	1,790	1,810
	VSP™ 販売量 t/月		(240)	(390)	(420)	(430)	(370)	(510)	(560)	(550)	(570)	(550)	(660)	(720)	(690)	(730)	(710)	(720)	(840)	(780)
	MicroThin™ (a) + (b) 販売量 k-m2/月		2,480	2,650	2,220	2,060	2,350	3,120	3,480	3,430	3,610	3,410	4,070	4,510	4,290	4,230	4,260	3,970	3,700	3,840
	HDI向け MicroThin™ (a) 販売量 k-m2/月		(600)	(530)	(470)	(430)	(510)	(530)	(650)	(690)	(470)	(590)	(550)	(570)	(560)	(560)	(560)	(560)	(560)	(560)
	PKG向け MicroThin™ (b) 販売量 k-m2/月		(1,880)	(2,120)	(1,750)	(1,630)	(1,840)	(2,590)	(2,830)	(2,740)	(3,140)	(2,820)	(3,520)	(3,940)	(3,730)	(3,670)	(3,700)	(3,410)	(3,140)	(3,280)
	二輪触媒 販売量 指数		100	100	94	92	97	97	103	101	103	101	102	107	104	99	102	102	98	100
	インド向け 販売量 指数		(100)	(101)	(87)	(83)	(93)	(87)	(98)	(97)	(101)	(96)	(98)	(104)	(101)	(95)	(98)	(100)	(93)	(97)
	インドネシア向け 販売量 指数		(100)	(123)	(110)	(117)	(112)	(103)	(123)	(110)	(108)	(111)	(99)	(129)	(114)	(114)	(114)	(110)	(110)	(110)
	その他地域向け 販売量 指数		(100)	(89)	(102)	(101)	(98)	(115)	(104)	(105)	(104)	(107)	(110)	(104)	(107)	(101)	(104)	(103)	(103)	(103)
	四輪触媒 販売量 指数		100	98	100	95	98	94	95	96	95	95	88	92	90	99	94	94	95	94
金属	半導体装置 保護材料 販売量 指数		100	101	126	130	114	131	125	124	153	133	117	140	129	89	109	140	139	140
	亜鉛 生産量 千t		56	47	56	58	216	53	52	47	42	194	45	58	103	115	218	108	118	226

指数：2024年Q1を100として表示

セグメントごとの状況についてご説明いたします。まず、機能材料セグメントの主要製品の動向です。資料の12ページをご覧ください。

- 今回内容を若干見直し、銅箔MicroThin™の販売量を実数表示といたしました。銅箔事業については、26年度に入りMicroThin™およびAIサーバー向け電解銅箔VSP™は、昨年以上に実需が旺盛であります。期初予想に対しては、MicroThin™の販売数量は増加の一方、VSP™は少々数量減となっております。また、本日生産能力増強を発表した薄型基板内蔵キャパシタ材料、FaradFlex®も堅調に推移しております。
- 排ガス浄化触媒については、期初予想比では二輪向けは好調を維持しております。四輪向けは中国にて苦戦はしているものの、通期では期初予想並みの数量を見込んでおります。

セグメントの業績（1） 機能材料



(単位：億円)

	26/Q1 実績	25/Q1 実績	増減 (26-25)	上2026 今回予想	上2025 実績	増減 (26-25)	FY2026 今回予想	FY2025 実績	増減 (26-25)
■売上高	1,006	713	293	2,080	1,505	575	4,110	3,284	826
■営業利益	183	129	54	395	280	115	790	675	115
■経常利益	182	105	77	390	265	125	780	665	115
※実力損益	165	97	68	360	242	118	749	616	133

※実力損益：経常利益から在庫要因・触媒貴金属価格影響を除いたもの

(機能材料製品)	(主な用途)
銅箔	・高密度半導体パッケージ材料 ・プリント配線基板
触媒	・二輪車・四輪車排ガス浄化触媒
機能性粉体 (電池材料)	・ハイブリッド車向けニッケル水素電池 ・リチウムイオン電池
機能性粉体 (機能粉)	・各種電子部品
レアメタリアル	・ガラス研磨材 ・各種電子部品
セラミックス	・高温用窯道具、電子部品用窯道具 ・溶融アルミニウム濾過装置
薄膜材料	・フラットパネルディスプレイ
HRDP ※1	・次世代半導体パッケージ用キャリア

経常利益の増減説明

【上2025→上2026予想 +125】

銅箔	+119 (MicroThin™・VSP™増販 他)
触媒	-7 (貴金属価格影響悪化 他)
薄膜	+25 (在庫要因好転 他)
本部	-27 (事業推進コスト 他)

【FY2025→FY2026予想 +115】

銅箔	+151 (MicroThin™・VSP™増販 他)
触媒	-12 (貴金属価格影響悪化 他)
薄膜	+14 (在庫要因好転 他)
本部	-36 (事業推進コスト 他)

※1 2025年10月にHRDP事業を事業創造本部から移管

続いて、機能材料セグメントのご説明です。資料の14ページをご覧ください。

- ・対前年同期経常利益は上期予想ならびに通期予想とも、銅箔においてはMicroThin™、VSP™の増販が寄与しております。
- ・触媒では、貴金属価格下落のマイナス影響による減益、薄膜材料での在庫要因好転等もあり、機能材料セグメントの26年度経常利益の見通しは上期で390億円、通期で780億円を見込んでおり、いずれも前期比で増益となっております。なお、期初の通期予想経常利益は670億円でありましたので、今回予想では110億円の増益となっております。

セグメントの業績（２） 金属



(単位：億円)

	26/Q1 実績	25/Q1 実績	増減 (26-25)	上2026 今回予想	上2025 実績	増減 (26-25)	FY2026 今回予想	FY2025 実績	増減 (26-25)
■売上高	983	740	242	2,100	1,612	488	4,300	3,767	533
■営業利益	53	29	23	110	177	-67	240	708	-468
■経常利益	68	33	35	130	184	-54	265	751	-486
※実力損益	39	56	-17	112	157	-45	246	555	-309

※実力損益：経常利益から在庫要因を除いたもの

経常利益増減分析

	上2025→ 上2026予想	FY2025→ FY2026予想
相場(亜鉛・鉛)・為替	39	50
T/C条件(亜鉛)	0	1
棚卸資産在庫要因	-9	-177
持分法損益	24	-4
エネルギーコスト (上記のうち、コークス)	-10 (-4)	-31 (-8)
その他※	-98	-325
合計	-54	-486

2026年度年間損益感応度（経常損益）

	フルオープン	予約含む
亜鉛(LME)	± 100\$/t	14.8
鉛(LME)	± 100\$/t	2.3
為替	± 1yen/\$	6.5

亜鉛TC条件

FY2025	80 \$/t
FY2026	85 \$/t

※その他の主な内訳

上2025→ 上2026予想	亜鉛製錬操業差 -5、亜鉛鉛製錬副産物 +20、鉛原料構成差 -46、亜鉛鉛製錬コスト(大定修-20含む) -55、銅製錬操業度差 -48、資源 +29
FY2025→ FY2026予想	亜鉛製錬操業差 +40、亜鉛鉛製錬副産物 -5、鉛原料構成差 -92、亜鉛鉛製錬コスト(大定修-20含む) -71、銅製錬操業度差 -132、銅製錬コスト(大定修-26含む) -32、貴金属リサイクル -24

Copyright © Mitsui Kinzoku Co., Ltd. or its affiliates All Rights Reserved.

15

次に、金属セグメントのご説明になります。資料15ページ、左下の経常利益増減分析をご覧ください。

- 26年度のLME相場について、亜鉛は前期より高い水準で推移しており、また、為替も円安傾向で推移していることから、相場および為替影響額は対前期で上期は39億円、通期は50億円のプラス影響となっております。一方、棚卸資産の在庫要因は、下期において昨年度下期の在庫要因プラス160億円が剥落することから、通期で177億円のマイナス影響となっております。
- その他の要因として、対前期で上期98億円のマイナス影響、通期では325億円のマイナス影響となっております。こちらは、大定修の影響を含めた亜鉛、鉛事業のコスト影響、銅製錬事業の操業度差などによるものでございます。これにより経常利益は対前期で上期は54億円の減益で130億円、通期では486億円の減益で265億円の経常利益となっております。
- 金属セグメントの期初通期予想計上利益は375億円でありましたので、今回予想では110億円の減益となります。
- 最後になりますが、本日、当社は2030年に向けての銅箔成長商品であるVSP™、MicroThin™、FaradFlex®の生産能力増強を発表いたしました。長らく市場からの増産期待が寄せられておりましたが、今後とも成長市場に投資しないことが最大のリスクとならぬよう、顧客への供給責任を果たすべく、適切な生産能力を適切な時期に投資し、企業価値拡大に努めてまいります。

■ 質疑応答

【機能材料セグメント】

- Q. 銅箔の生産能力増強について、MicroThin™、VSP™、FaradFlex®それぞれの投資判断の背景を教えてください。
- A. MicroThin™の生産能力増強について、従来通りPKG 向けの AI サーバー等のメモリの増加と、新用途の光トランシーバー向けが大きく伸びると見ている。特に光トランシーバー向けが当初想定以上に伸びてきており、従来の生産能力計画を超えると判断した。なお、稼働率に関しては、従来は 70%程度を基準にそれを上回る場合は増強検討と考えていたが、今回の生産能力増強では生産量と販売数量を精査中ではあるものの稼働率を 80%程度と見込んでいる。VSP™について、需要が活況であるマーケットの伸びに対して能力を上げていくためである。当社が VSP™のマーケットを全てカバーするとは考えていないが、当社が強みを発揮できる HVL4 以上のカテゴリーの販売比率が高まって行くと思込んでいる。FaradFlex®は、主に AI サーバーのスイッチで当社の想定以上に採用が広がっているため増強を決定した。
- Q. ROIC 戦略について、銅箔の 2025 年度実績は 52%で、2030 年度には 64%を目指すことになっている。今回の増産により投下資本が先行して膨らむことになるが、ROIC 目標を実現するために、値上げを積極的に取り組む必要もあると思うがどのように考えているか。
- A. ROIC は当然意識しており、2030 年度目標の 64%と遜色ない水準でキープできると見込んでいる。値上げに関しても、今後の状況を見てコストアップ等があれば適切なマージンを維持すべく値上げ等実施していく方針に変わりはない。
- Q. 銅箔の利益について、通期見通しの営業利益が前回予想より 97 億円上方修正している要因を解説いただきたい。
- A. 銅箔の利益の上方修正について、まず MicroThin™と電解銅箔の販売数量の増減影響で合計して約 40 億円の増益を見ている。値上げについて、前回予想では集計途中だったこともあり織り込めなかった部分と追加の値上げにより約 35 億円増益となっている。内訳は、MicroThin™が約 30 億円、VSP™が 5 億円から 10 億円程度である。電解銅箔の平均販売単価差はほぼ前回予想並みで見込んでいる。また、銅価上昇による原料代の悪化を約 25 億円と見ており、それ以外の変動費、固定費、販管費は前回並みで見ている。在庫関係は銅価上昇により約 10 億円の好転、為替はマージン影響と営業外を合わせて約 10 億円好転と見ている。残りの約 30 億円は、大部分が FaradFlex®の利益好転を見ている。
- Q. 決算説明資料 P.12 について、VSP™と MicroThin™の前回予想からの販売数量の変化を解説いただきたい。
- A. VSP™については、ハイエンドサーバー向けの需要が非常に好調に推移している。前回予想比で数量減を見込んでいる背景は、増産投資し拡販を進めているマレーシア銅箔で製品の顧客認定が想定よりも遅れている影響を織り込んでいる。ただし、顧客認定が今後順調に進捗すれば上振れ余地もあると見ている。MicroThin™の HDI 向けについては前回予想通りで、PKG 向けについては、特にサーバーのメモリ用途において非常に需要が強く販売数量も好調に推移している。前回予想では先行きを若干保守的に見ていたが、足元の非常に強い需要を踏まえて上期、下期ともに見直した。足元の好調が年度末まで続くかはまだ不透明な部分もあるため、下期見直しには若干の季節性のマイナスを織り込んでいる。
- Q. MicroThin™の値上げについて、2026 年 3 月に申し入れたものから更に追加の値上げはないか。需給はかなり逼迫していると見られるので、下期以降の値上げの可能性はあるか。
- A. MicroThin™の更なる値上げは足元は特に予定していないが、銅価が高止まりしていることや、コストや需給の状況も踏まえて引き続き検討していく。
- Q. MicroThin™の高速光トランシーバー向けについて、今年度の販売数量をどう見ているのか。また、今回能力増強の決定にあたって光トランシーバー向けが爆発的に増えていく見込が背景にあると思うが、規格が 400 ギガから 800 ギガとなり、今後 1.6、2.4、3.2 テラとなる中でどのような前提を置いているか教えてください。

A. 2026 年度の販売数量は、前回予想の時点では月当たり 20 万平米から 25 万平米ぐらいで見えていたが、足元の非常に強い実績を踏まえて今回見直しており、2026 年度の平均販売数量として月当たり 60 万平米を超える数量を見込んでいる。400 ギガ、800 ギガ、1.6 テラと世代が進んでいく中で、足元 800 ギガでは採用率としてほとんどの光トランシーバーで MicroThin™が使われ、次の世代の 1.6 テラにおいても引き続き MicroThin™は使われると見込んでいる。1.6 テラや 2.4 テラと世代が進むことでの MSAP 工法から SAP 工法への切り替わりは見込んでおらず、光トランシーバーの個数が増えていくのに伴って MicroThin™の販売量が増えていくことが十分に期待できると考えている。

Q. VSP™の値上げについて教えていただきたい。

A. 2025 年度 10 月以降適用で値上げを実施していたが、2026 年 7 月以降適用の追加の値上げを実施した。足元の旺盛な需要を踏まえたもので、全てのグレードの価格を一律に引き上げるものではないが、需要の強いところには一定程度の付加価値を認めていただくような値上げの仕方を行っている。

Q. マレーシア銅箔の VSP™の顧客認定遅れは三井金属側の問題ではないという理解でよいか。この遅れはシェアに大きな影響はないのか。

A. ご理解のとおりである。設備の立ち上がりは予定どおりで品質に問題もなく、手続き的な遅れと考えている。なお、顧客認定遅れのシェアへの影響も特に無いと見ている。

Q. VSP™のグレード別の変化や競合状況について解説いただきたい。台湾や韓国の競合の影響はどうか。

A. VSP™のカテゴリー別の状況について、HVLP4 以上のスーパーハイグレード品の VSP 販売数量に占める割合は、上期は約 45%と見込んでおり、前回予想の約 40%より少し上がっている。下期は約 60%で前回予想と変わっていない。競合状況は、HVLP の各カテゴリーで市場が急拡大する中で競合も参入してきており、その状況下で当社は低いカテゴリーでは積極的に受注を目指さず高いカテゴリーに注力する方針を進めているため、HVLP の低いカテゴリーではいくらか変化が起きている。ただし、HVLP の高いカテゴリーにおいては、技術的な難度が高い製品であることから競合となる安定した品質で製造できる会社は引き続き限られると考えており、競争環境に大きな変化は無く、当社の強みである安定した品質と供給体制によりトップサプライヤーにあると考えている。

Q. FaradFlex®について、足元急速に伸びている背景を教えていただきたい。また、MLCC との棲み分けをどのように考えているか。

A. FaradFlex®は AI インフラ関連で需要が急増しており、メインは AI サーバーのスイッチ向けである。MLCC との棲み分けは、FaradFlex®を採用するメリットが基板設計の自由度が向上する部分のため、補完関係ではないかと考えている。

【金属セグメント】

Q. 決算説明資料 P.15 で、金属事業の経常利益増減分析の対前年度比のうち、その他の項目の銅製錬操業差がマイナス 132 億円と大きいので解説いただきたい。

A. 亜鉛以外の金属の市況影響として、金や銀の価格が 1 月下旬辺りの非常に高い水準から足元かなり下がってきている影響が大きく出ている。銅製錬操業差は当社の岡山の製錬所での銅・金・銀の差量で、前年度は非常に好調だった部分を前回予想では外して織り込んでいたが、3 カ月の実績が出たところで、差量の数量が見込みより少なかったことと、金・銀の価格が下がっている影響織り込んだためマイナスが大きくなっている。前回予想比での悪化は、数量減と価格の低下が同じぐらいの金額規模で減益影響となっている。

Q. 期初時点での金・銀の価格前提と、今回予想での第 2 四半期以降の金・銀の価格前提はどう置いたか。

A. 期初時点の金・銀の価格前提は金が 4,800\$/oz、銀が 80\$/oz である。今回予想での第 2 四半期以降は、金が 4,200\$/oz、銀が 65\$/oz としている。

以上